This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

国特許 日 PATENT OFFICE JAPANÈSE GOVERNMENT

WIPO PCT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office. #3/BUOWW 5/17/01 C.//Khuny

出願年月日 Date of Application:

1999年 6月11日

出 顒 Application Number:

平成11年特許願第165236号

出 Applicant (s):

セイコーエプソン株式会社

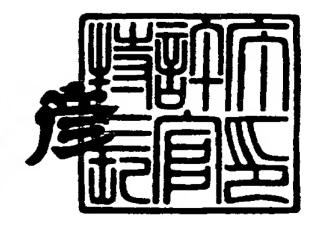
27 JUL 2000 **PCT WIPO**

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2000年 6月29日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office



特平11-165236

【書類名】

特許願

【整理番号】

J0073813

【提出日】

平成11年 6月11日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

G02F 1/1333

【発明の名称】

液晶装置及びその製造方法

【請求項の数】

6

【発明者】

【住所又は居所】

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株

式会社内

【氏名】

宮崎 貴史

【特許出願人】

【識別番号】

000002369

【氏名又は名称】

セイコーエプソン株式会社

【代表者】

安川 英昭

【代理人】

【識別番号】

100093388

【弁理士】

【氏名又は名称】

鈴木 喜三郎

【連絡先】

0266-52-3139

【選任した代理人】

【識別番号】

100095728

【弁理士】

【氏名又は名称】

上柳 雅誉

【選任した代理人】

【識別番号】

100107261

【弁理士】

【氏名又は名称】 須澤 修

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013044

【納付金額】

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

21,000円

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9711684

【プルーフの要否】 要

【書類名】

明細書

【発明の名称】

液晶装置及びその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 シール材と異方性導通材とが互いにつながって環状に形成されたシール部と、そのシール部によって互いに貼り合わされた一対の基板と、それらの基板に形成された電極とを有する液晶装置において、

前記一対の基板のうち前記異方性導通材が形成される側の基板にその異方性導 通材の位置を確認可能なアライメントマークを設けたことを特徴とする液晶装置

【請求項2】 請求項1において、前記アライメントマークは前記異方性導通材が形成される領域の内部に設けられることを特徴とする液晶装置。

【請求項3】 請求項1又は請求項2において、前記アライメントマークはそのアライメントマークが形成される基板に形成される電極と同じ材質であることを特徴とする液晶装置。

【請求項4】 第1基板母材に液晶パネル複数個分の第1電極を形成する第 1電極形成工程と、

前記第1基板母材の各液晶パネル部分にシール材を上下導通部を除いて環状に 形成するシール材形成工程と、

第2基板母材に液晶パネル複数個分の第2電極を形成する第2電極形成工程と

前記第2基板母材の各液晶パネル部分の上下導通部に異方性導通材を形成する 導通材形成工程と、

前記シール材と前記異方性導通材とが互いにつながるように前記第1基板母材と前記第2基板母材とを貼り合わせて、複数の液晶パネル部分を含む大面積のパネル構造体を形成する基板貼り合わせ工程と、

前記複数の液晶パネル部分の内部に液晶を封入する液晶封入工程と、

前記大面積のパネル構造体を個々の液晶パネルへと分割するパネル分割工程と を有する液晶装置の製造方法において、

前記導通材形成工程において形成される異方性導通材と重なる位置の第2基板

母材上に前記第2電極形成工程において第2電極と同時にアライメントマークを 形成する

ことを特徴とする液晶装置の製造方法。

【請求項5】 請求項4において、前記シール材及び前記異方性導通材のうちそれらが互いにつながる部分を他の部分に比べて細く形成することを特徴とする液晶装置の製造方法。

【請求項6】 請求項4又は請求項5において、前記アライメントマークは前記上下導通部以外の第2基板母材上に設けられることを特徴とする液晶装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、一対の基板間に封止した液晶の配向を制御することによって文字、数字、絵柄等といった像を表示する液晶装置に関する。また、本発明は、そのような液晶装置の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】

液晶装置は、一般に、液晶パネルにバックライト等といった照明装置や液晶駆動用ICを付設することによって形成される。また、液晶パネルは、電極が形成された一対の基板をそれらの電極が互いに対向するようにシール部を間に挟んで貼り合わせ、それらの基板の間に形成されるセルギャップ内に液晶を封入し、さらにそれらの基板の外側表面に偏光板を貼着することによって形成される。

[0003]

従来の液晶装置として、図11に示すように、シール材52とそれにつながる 異方性導通材53とによって環状のシール部54を形成し、そのシール部54に よって一対の基板、すなわち第1基板56a及び第2基板56bを互いに貼り合 わせた構造のものが知られている。この液晶装置では、第1基板56aが第2基 板56bの外側へ張り出す基板張出し部56cを有し、その基板張出し部56c に複数の端子配線61が形成される。 [0004]

第1基板56aの表面には第1電極59aが形成され、第2基板56bの表面には第2電極59bが形成される。そして、第1電極59aは直接に端子配線61につながり、第2電極59bは異方性導通材53の中に含まれる導電粒子を介して端子配線61に導電接続される。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

上記従来の液晶装置において、異方性導通材53は一般に印刷等によって第2 基板56bの表面に形成される。この異方性導通材53はシール材52と協働してシール部54を形成しなければならないので、その位置は正確に決められていなければならない。

[0006]

異方性導通材53が第2基板56b上の正確な位置に形成されているかどうかを検査するため、従来は、異方性導通材53に関して第2基板56bの端辺からの寸法を測定して位置を検査していた。しかしながら、そのような寸法測定は非常に面倒であった。

[0007]

本発明は、従来の液晶装置に関する上記の問題点に鑑みて成されたものであって、シール部の一部に異方性導通材を設ける構造の液晶装置に関して、異方性導通材の位置を極めて簡単に検査できるようにすることを目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】

(1) 上記の目的を達成するため、本発明に係る液晶装置は、シール材と異方性導通材とが互いにつながって環状に形成されたシール部と、そのシール部によって互いに貼り合わされた一対の基板と、それらの基板に形成された電極とを有する液晶装置において、前記一対の基板のうち前記異方性導通材が形成される側の基板にその異方性導通材の位置を確認可能なアライメントマークを設けたことを特徴とする。

[0009]

この液晶装置によれば、異方性導通材の位置をアライメントマークを基準として検査できるので、その検査を目視等によって極めて簡単に正確に行うことができる。

[0010]

(2) 上記構成の液晶装置において、前記アライメントマークは前記異方性 導通材が形成される領域の内部に設けることができる。アライメントマークは異 方性導通材の位置が正しいかどうかを判定する際の基準となれば良く、その作用 が達成されるならばアライメントマークは必ずしも異方性導通材と重ならない位 置に設けることもできる。しかしながら、アライメントマークを異方性導通材が 形成される領域の内部に設けることにすれば、アライメントマークと異方性導通 材とを直接的に比較することができ、よって判定の精度を高めることができる。

[0011]

(3) 上記構成の液晶装置において、前記アライメントマークはそのアライメントマークが形成される基板に形成される電極と同じ材質によって形成することができる。この構成によれば、基板上に電極を形成する際にアライメントマークを同時に形成することができるようになり、そのため、アライメントマークを簡単に形成できる。

[0012]

(4) 次に、本発明に係る液晶装置の製造方法は、第1基板母材に液晶パネル複数個分の第1電極を形成する第1電極形成工程と、前記第1基板母材の各液晶パネル部分にシール材を上下導通部を除いて環状に形成するシール材形成工程と、第2基板母材に液晶パネル複数個分の第2電極を形成する第2電極形成工程と、前記第2基板母材の各液晶パネル部分の上下導通部に異方性導通材を形成する導通材形成工程と、前記シール材と前記異方性導通材とが互いにつながるように前記第1基板母材と前記第2基板母材とを貼り合わせて複数の液晶パネルを含む大面積のパネル構造体を形成する基板貼り合わせ工程と、前記複数の液晶パネル部分の内部に液晶を封入する液晶封入工程と、前記大面積のパネル構造体を個々の液晶パネルへと分割するパネル分割工程とを有する液晶装置の製造方法にお

いて、前記導通材形成工程において形成される異方性導通材と重なる位置の第2 基板母材上に前記第2電極形成工程において第2電極と同時にアライメントマークを形成することを特徴とする。

[0013]

この液晶装置の製造方法によれば、異方性導通材の位置をアライメントマークを基準として検査できるので、その検査を目視等によって極めて簡単に正確に行うことができる。

[0014]

(5) 上記構成の液晶装置の製造方法においては、前記シール材及び前記異方性導通材のうちそれらが互いにつながる部分を他の部分に比べて細く形成することができる。一般に、第1基板と第2基板の両方を互いに貼り合わせるとシール部は押圧されて幅方向へ広がる。特に、シール材と異方性導通材とが重なる部分ではそれらの両方が幅方向へ広がるので、広がり寸法が他の部分に比べてより広くなることが考えられる。これに対し、(5)の構成によれば、シール材と異方性導通材とが重なる部分の幅の広がりを小さく抑えることができる。

[0015]

(6) 上記構成の液晶装置の製造方法において、前記アライメントマークは前記上下導通部以外の第2基板母材上に設けることができる。アライメントマークは、もちろん、上下導通部を構成する異方性導通材に重なる位置に設けることができるが、本発明はそのような構成に限定されるものではなく、上下導通部以外の個所に形成した、いわゆるダミーの異方性導通材に重なる位置に設けることもできる。この場合、ダミーの異方性導通材は本来の導電接続用の要素として働くのではなく、上下導通部を構成する異方性導通材が正常な位置にあるかどうかを間接的に検査するために用いられる。

[0016]

【発明の実施の形態】

(第1実施形態)

図1は、本発明に係る液晶装置の主要部である液晶パネル1の一実施形態を示している。また、図2は、図1のII-II線に従ってその液晶パネル1の断面

構造を示している。液晶装置は、この液晶パネル1にバックライト等といった照明装置や、液晶駆動用ICや、その他各種の付帯機器を付設することによって作製される。

[0017]

液晶パネル1は、シール材2と異方性導通材3とが互いにつながって環状に形成されたシール部4と、そのシール部4によって貼り合わされて互いに対向する一対の基板6a及び6bとを有する。

[0018]

図2に示すように、第1基板6 a は第1基板素材12 a の内側表面、すなわち第2基板6 b に対向する表面に形成された第1電極9 a と、その上に形成されたオーバーコート層13 a と、さらにその上に形成された配向膜14 a とを有する。一方、第2基板6 b は第2基板素材12 b の内側表面に形成された第2電極9 b と、その上に形成されたオーバーコート層13 b と、さらにその上に形成された配向膜14 b とを有する。なお、図1では構造を分かり易く示すために配向膜14 a 、14 b 及びオーバーコート層13 a 、13 b の図示を便宜上省略してある。

[0019]

第1基板素材12a及び第2基板素材12bは、例えばガラス、プラスチック等といった光透過性材料によって形成される。また、第1電極9a及び第2電極9bは、例えばITO (Indium Tin Oxide:インジウムスズ酸化物)等といった光透過性を有する導電材料によって形成される。また、オーバーコート層13a及び13bは、例えば酸化珪素、酸化チタン、又はこれらを含む混合物等によって形成される。また、配向膜14a及び14bは、例えばポリイミド系樹脂によって形成される。

[0020]

図1において、シール材2は、例えばエポキシ系樹脂を材料として印刷等によって所定形状に形成される。また、異方性導通材3は図2に示すように、非導電性の樹脂剤7の中に導電粒子8を分散させることによって形成されている。第1電極9aは、図1に示すように、複数の直線状の配線パターンとして形成され、

また、第2電極9bは第1電極9aに対して直角の方向に延びる複数の配線パターンとして形成されている。第1電極9aと第2電極9bとが交差する点はドットマトリクス状に配列し、これらの点が像を形成するための画素を構成し、これらの画素の集まりによって液晶表示領域が構成される。

[0021]

第1基板6aは第2基板6bの外側へ張り出す基板張出し部6cを有する。そしてその基板張出し部6cの表面には複数の直線状の配線パターンである端子配線11が形成されている。図3は、第2基板6bが貼り合わされる前の第1基板6aを平面的に示している。本実施形態では第1基板6aにシール材2が形成されるものとし、このシール材2は上下導通部Aを除いて環状に形成されており、さらにその一部に液晶注入口2aが形成されている。

[0022]

また、第1電極9aは端子配線11の中央領域部分のものに直接につながっている。また、端子配線11の両脇部分のものは上下導通部Aまで延びている。なお、図3では、便宜的に、オーバーコート層13a及び配向膜14aの図示を省略してある。

[0023]

図4は、第1基板6aが貼り合わされる前の第2基板6bを平面的に示している。第2電極9bの一端は第2基板6bの周辺部を回って上下導通部Aまで延びている。また、上下導通部Aの所に異方性導通材3が印刷等によって形成される。異方性導通材3を形成すべき位置には、図5に示すように、第2電極9bを形成するのと同時に、第2電極9bと同じ材料、本実施形態ではITOによって所定パターンのアライメントマーク16が前もって形成される。

[0024]

このように本実施形態では、上下導通部Aに異方性導電材3を形成するのに先立ってそれが形成されるべき位置に前もってアライメントマーク16を形成しておくので、第2基板6b上に形成された異方性導電材3の位置が正常か否かをそのアライメントマーク16を基準として正確に目視によって判定できる。従来であれば、第2基板6bの端辺を基準として寸法を測定することによって異方性導

電材3の位置を確認しなければならないので作業が面倒であり、測定誤差も発生 し易かったが、本実施形態によればそのような不都合がなくなった。

[0025]

なお、図1〜図5の各図において、第1電極9a、第2電極9b及び端子配線 11は実際には極めて狭い間隔で多数本が第1基板6a又は第2基板6bの表面 に形成されるものであるが、図1等では構造を分かり易く示すためにそれらの間 隔を広く描き、さらに必要な場合には一部を省略して示してある。

[0026]

図1の液晶パネル1を作製するにあたっては、図4に示す第2基板6bを図示の状態から裏返した状態で図3に示す第1基板6aにシール材2を挟んで貼り合わせる。このとき、第1基板6a(図3)の上下導通部Aと第2基板6b(図4)の上下導通部Aとが正確に一致するように両基板6a及び6bの相対位置が位置決めされる。

[0027]

その後、貼り合わされた基板6a及び6bを両者の外側から圧着、すなわち加熱及び加圧することにより、シール材2が硬化してそれらの基板6a及び6bが接着される。一方、上下導通部Aにおいては、第1基板6a上の端子配線11の先端と第2基板6b上の第2電極9bの先端とが、図2に示すように、異方性導通材3内の導電粒子8によって導電接続され、これにより、第2基板6bに形成された第2電極9bが第1基板6aの基板張出し部6c上の端子配線11として導き出される。

[0028]

その後、図1において、シール材2の一部に形成した液晶注入口2aを通して液晶パネル1の内部に液晶を注入し、その注入の完了後に液晶注入口2aを樹脂によって封止する。次に、第1基板6a及び第2基板6bの外側表面に偏光板17a及び17bを貼着することにより、液晶パネル1が完成する。

[0029]

また、液晶駆動用ICを実装した外部配線基板(図示せず)を端子配線11に 導電接続し、さらに第1基板6a又は第2基板6bのいずれか一方の外側表面に バックライト等といった照明装置又は光反射板を装着する等といった各種の追加 処理を施すことによって液晶装置が完成する。

[0030]

この液晶装置を作動するときには、第1電極9a又は第2電極9bの一方に液晶駆動用ICによって走査電圧を印加し、さらにそれらの電極9a又は9bの他方に液晶駆動用ICによってデータ電圧を印加する。この処理により、データ電圧が印加された画素の部分にある液晶の配向が変化して該部を通過する光が変調され、もって、第1基板6a又は第2基板6bのうち照明装置又は光反射板と反対側の基板の表面に希望の像が表示される。

[0031]

以下、図1に示す液晶装置、すなわち液晶パネル1の製造方法をより詳しく説明する。図6はその製造方法の一実施形態を工程図として示したものである。第1基板6a(図3)は工程P1~工程P5を経て形成される。具体的には、図7において、ガラス、プラスチック等から成る大面積の第1基板母材12a'に液晶パネル複数個分、すなわち第1基板6aの複数個分の第1電極9a及び端子配線11をITOを材料として周知のパターニング法、例えばフォトリソグラフィー法を用いて形成する(工程P1)。

[0032]

次に、酸化珪素、酸化チタン、又はこれらを含む混合物等を材料として、例えばオフセット印刷によってオーバーコート層13aを形成する(工程P2)。さらに、その上に、ポリイミド等を材料として例えばオフセット印刷によって配向膜14aを形成し(工程P3)、さらにラビングを行う(工程4)。そしてその後、例えばスクリーン印刷によってシール材2を所定形状、すなわち液晶注入口2a及び上下導通部Aを有する形状に形成する(工程P5)。以上により、図3に示す第1基板6aが複数個並べて形成された状態の大面積の第1基板母材12a、が形成される。

[0033]

一方、第2基板6b(図4)に関しては、図8に示すように、ガラス、プラス チック等から成る大面積の第2基板母材12b'に液晶パネル複数個分、すなわ ち第2基板6bの複数個分の第2電極9bをITOを材料として周知のパターニング法、例えばフォトリソグラフィー法を用いて形成する(工程P6)。そしてこのとき、図5に示すように、後の工程で異方性導通材3を形成すべき場所である上下導通部Aにアライメントマーク16を同時に形成する。

[0034]

その後、酸化珪素、酸化チタン等を材料として、例えばオフセット印刷によってオーバーコート層13bを形成し(工程P7)、その上にポリイミド等を材料として例えばオフセット印刷によって配向膜14bを形成し(工程P8)、さらにラビングを行う(行程P9)。そして、例えばスクリーン印刷によって異方性 導電材3を所定形状、例えば長方形状に形成して上下導通部Aを形成する(工程P10)。以上により、図4に示す第2基板6bが複数個並べて形成された状態の大面積の第2基板母材12b'が形成される。

[0035]

以上のように形成された第1基板母材12 a'及び第2基板母材12 b'は、その後、アライメントすなわち位置合わせされた状態で互いに貼り合わされ、さらに圧着処理すなわち加熱処理及び加圧処理を受けることにより、シール材2及び異方性導電材3によって互いに貼り合わされる(工程P11)。こうして、複数の液晶パネルを含んだ大面積のパネル構造体が形成される。

[0036]

次に、大面積のパネル構造体を1次ブレイクしてシール材2の一部に形成された液晶注入口2a(図1参照)を外部へ露出させ(工程P12)、さらにその液晶注入口2aを通して各液晶パネル部分の内部に液晶を注入し、その注入の完了後に液晶注入口2aを樹脂によって封止する(工程P13)。その後、2次ブレイクを行うことにより、図1に示す液晶パネル1であって偏光板17a及び17bが貼着されていないものが形成される(行程P14)。

[0037]

上述した本実施形態に係る液晶装置の製造方法では、図4に示すように第2基板12bの所定位置に異方性導電材3を形成する(図6の工程P10)のに先立って、図5に示すように異方性導通材3を形成すべき位置である上下導通部Aの

所に前もってアライメントマーク16を形成する(図6の工程P6)。従って、工程P10が完了して異方性導通材3を形成した後、製造者は、異方性導通材3が正規の位置に正確に形成されているかどうかをアライメントマーク16を基準として、例えば目視によって簡単且つ正確に検査できる。この検査は、基板組付け工程P11の前に行うことができるので、誤って不良品を基板組付け工程P11へ供給してしまうという不都合を回避できる。

[0038]

(第2実施形態)

図9及び図10は、本発明に係る液晶装置及びその製造方法の他の実施形態の主要部を示している。図9(a)は、図3に示した実施形態における符号Bで示す部分に相当している。また、図9(b)は、図4に示した実施形態における符号Cで示す部分に相当している。そして、図10は、図9(b)の第2基板12bを図示の状態から裏返して図9(a)の第1基板12aに貼り合わせた状態を示している。

[0039]

この実施形態が図1に示した第1実施形態と異なる点は、図9(a)のシール材2及び図9(b)の異方性導通材3のうち、それらが互いにつながる部分2b及び3bを他の部分に比べて細く形成したことである。

[0040]

一般に、第1基板6aと第2基板6bの両方を互いに貼り合わせるとシール部4、すなわちシール材2及び異方性導通材3の両方は押圧されて幅方向へ広がる。特に、シール材2と異方性導通材3とが互いに重なる部分2b及び3bではそれらの両方が幅方向へ広がるので、広がり寸法が他の部分に比べてより広くなることが考えられる。

[0041]

本実施形態では、シール材2及び異方性導通材3のうちそれらが互いにつながる部分2b及び3bを他の部分に比べて細く形成したので、それらが基板6a及び6bの貼り合わせの際に押圧されて幅方向へ広がったとしても、その広がりの程度を小さく抑えることができる。

[0042]

(その他の実施形態)

以上、好ましい実施形態を挙げて本発明を説明したが、本発明はその実施形態 に限定されるものでなく、請求の範囲に記載した発明の範囲内で種々に改変でき る。

[0043]

例えば、図5及び図6に示した実施形態では、アライメントマーク16を異方 性導通材3が形成される領域に含まれるように形成したが、そもそもアライメントマーク16は異方性導通材3の位置を確認するために用いられるマークであり、その作用が達成されるのであるならば、アライメントマーク16は必ずしも異方性導通材3に含まれる領域ではなく、その領域から外れる位置に設けても良い。しかしながら実際上は、アライメントマーク16を異方性導通材3が形成される領域の内部に設ける方が、異方性導通材3の位置を確認する上でより望ましいと考えられる。

[0044]

また、図5の実施形態では、アライメントマーク16を矩形状に形成したが、 その形状は特定のものに限定されず、希望に応じた任意の形状にすることができる。

[0045]

また、図5の実施形態では、アライメントマーク16を上下導通部Aに対応させて、すなわち第2基板6bの第2電極9bと第1基板6a(図3参照)の端子配線11とを導電接続する部分を構成する異方性導通材3に対応させて形成した。しかしながら、アライメントマーク16は上下導通部A以外の部分の第2基板12b上又は上下導通部A以外の部分の第2基板母材12b'(図8参照)上に形成することもできる。

[0046]

なおこの場合には、アライメントマーク16と比較すべき異方性導通材3は、 上下導通部A以外であってアライメントマーク16と重なる位置にダミーパター ンとして、つまり本来の導通材としての働きではない位置確認用としてだけ働く パターンとして形成される。

[0047]

【発明の効果】

本発明に係る液晶装置及びその製造方法によれば、異方性導通材の位置をアライメントマークを基準として検査できるので、その検査を目視等によって極めて 簡単に且つ正確に行うことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明に係る液晶装置の主要部分である液晶パネルの一実施形態を一部破断して示す平面図である。

【図2】

図1のII-II線に従って液晶パネルの断面構造を示す断面図である。

【図3】

図1の液晶パネルを構成する一方の基板を示す平面図である。

【図4】

図1の液晶パネルを構成する他方の基板を示す平面図である。

【図5】

図4の基板の製造途中の状態を示す平面図である。

【図6】

本発明に係る液晶装置の製造方法の一実施形態を示す工程図である。

【図7】

図6の製造方法で用いられる大面積の第1基板の一例を示す平面図である。

【図8】

図6の製造方法で用いられる大面積の第2基板の一例を示す平面図である。

【図9】

本発明に係る液晶装置の他の実施形態の主要部である一対の基板のそれぞれの主要部を示す平面図である。

【図10】

図9に示す一対の基板を互いに貼り合わせた状態を示す平面図である。

【図11】

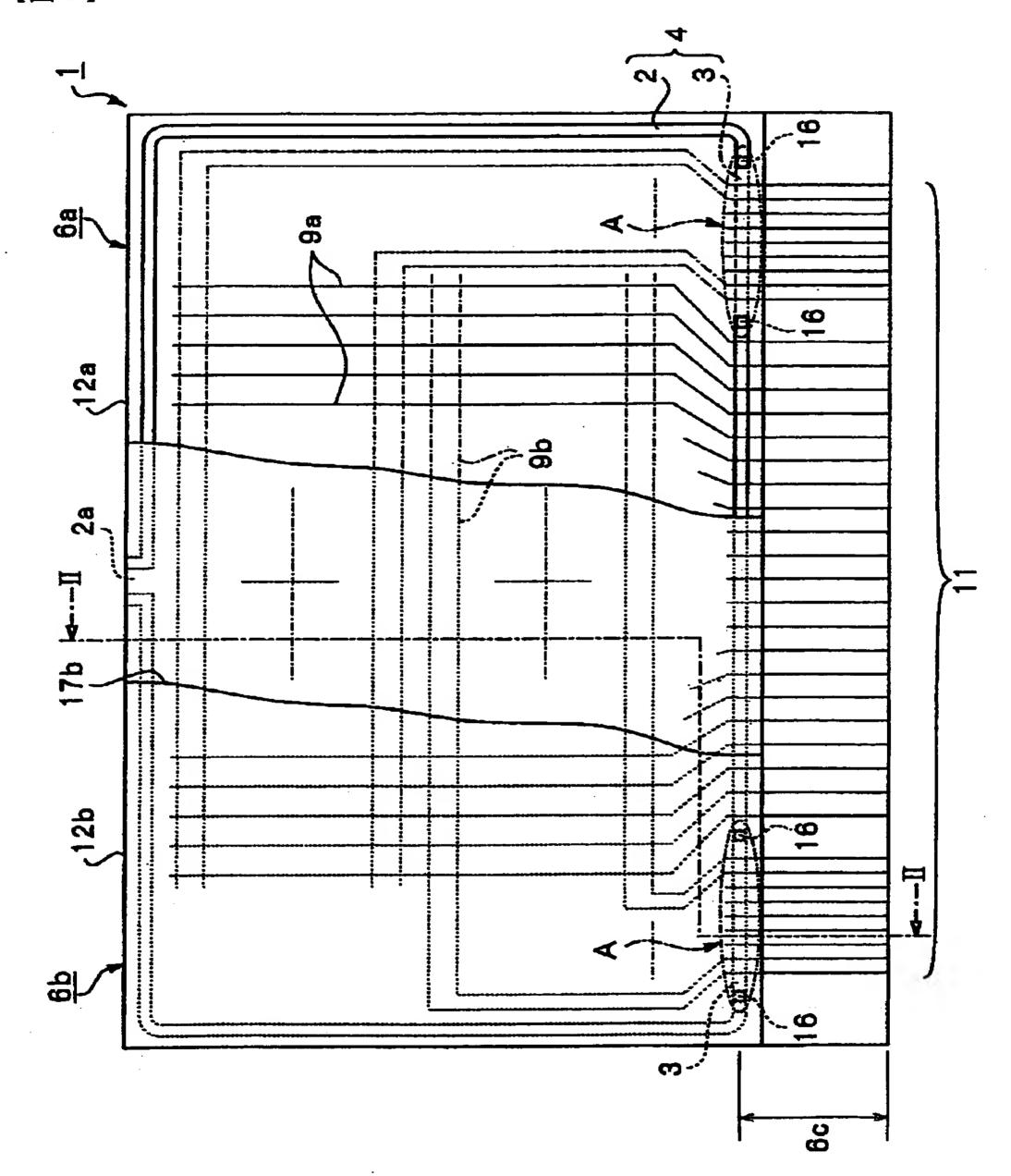
従来の液晶装置の一例を一部破断して示す平面図である。

【符号の説明】

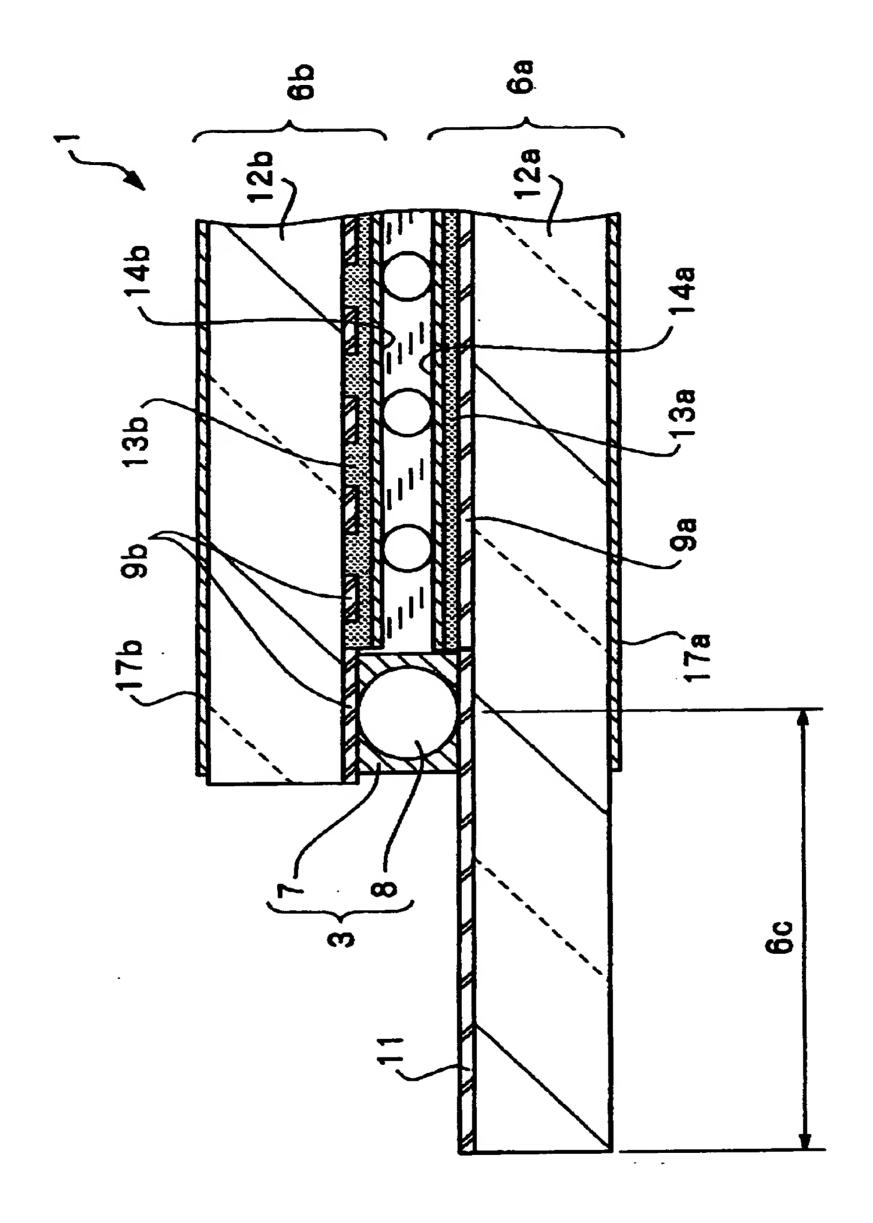
1	液晶パネル
2	シール材
2 a	液晶注入口
3	異方性導通材
4	シール部
6 a	第1基板
6 Ъ	第2基板
6 с	基板張出し部
7	樹脂剤
8	導電粒子
9 a	第1電極
9 Ъ	第2電極
1 1	端子配線
1 2 a	第1基板素材
12 a'	第1基板母材
1 2 b	第2基板素材
12b'	第2基板母材
1 6	アライメントマーク
Α	上下導通部

【書類名】 図面

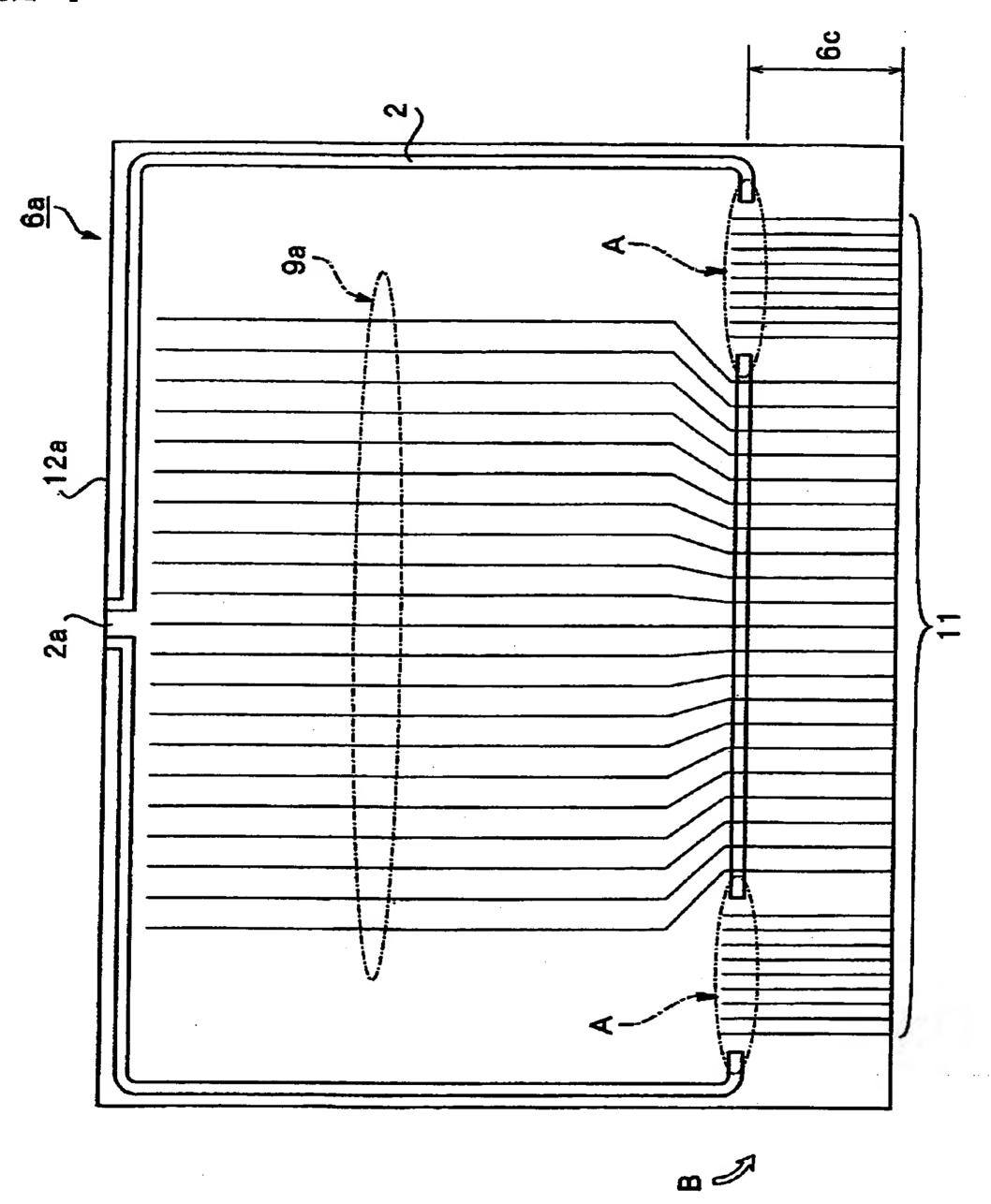
【図1】



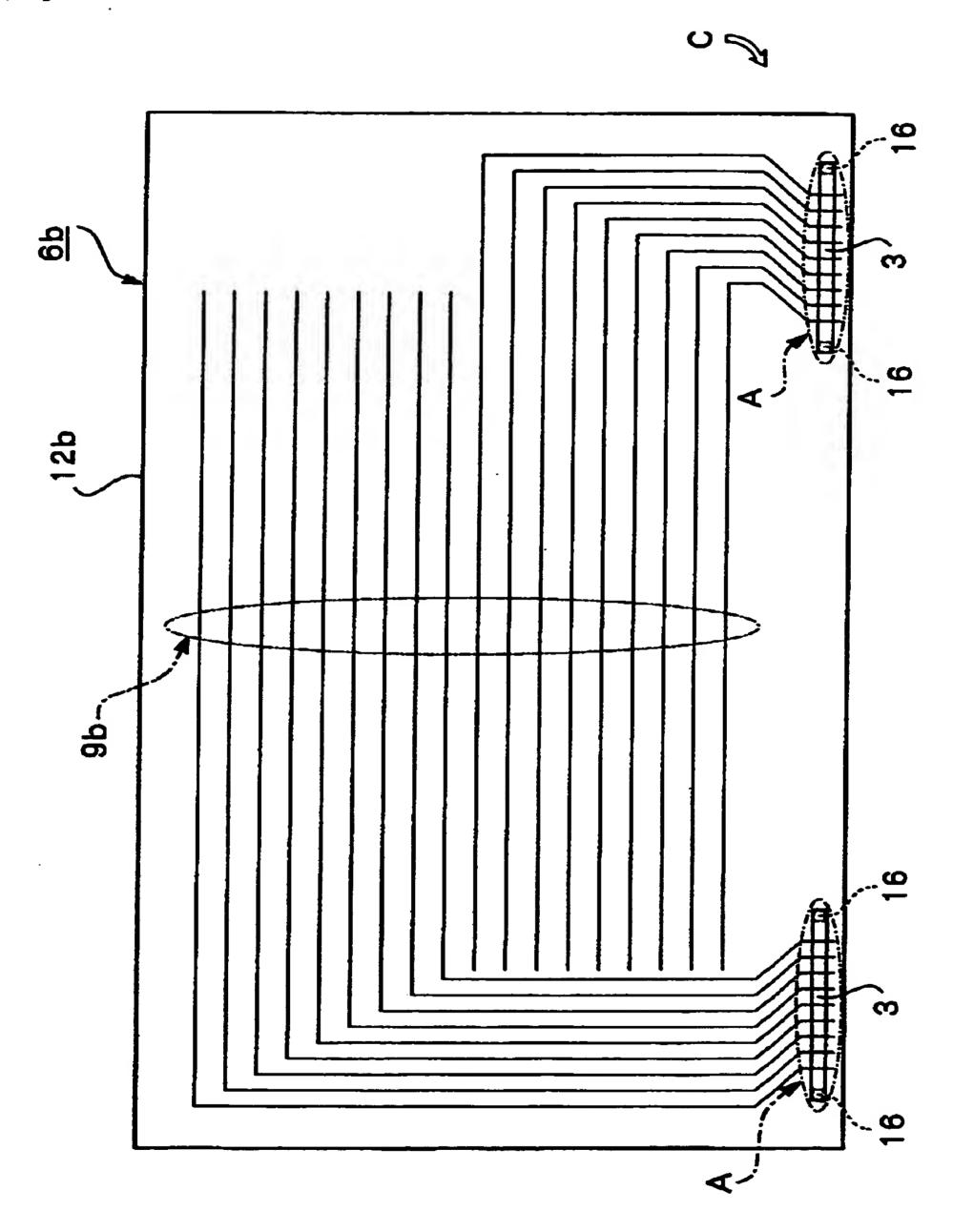
【図2】

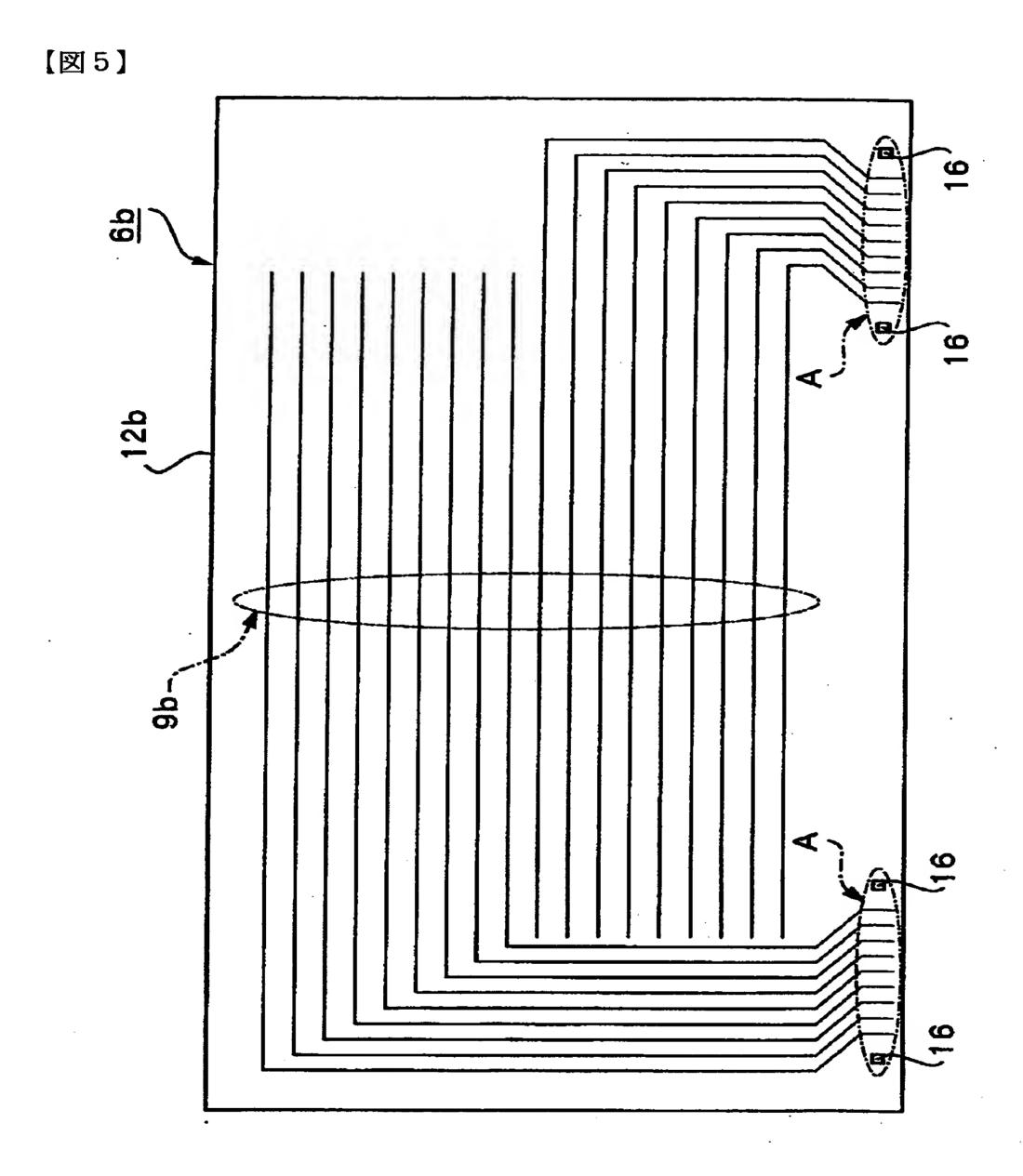


【図3】



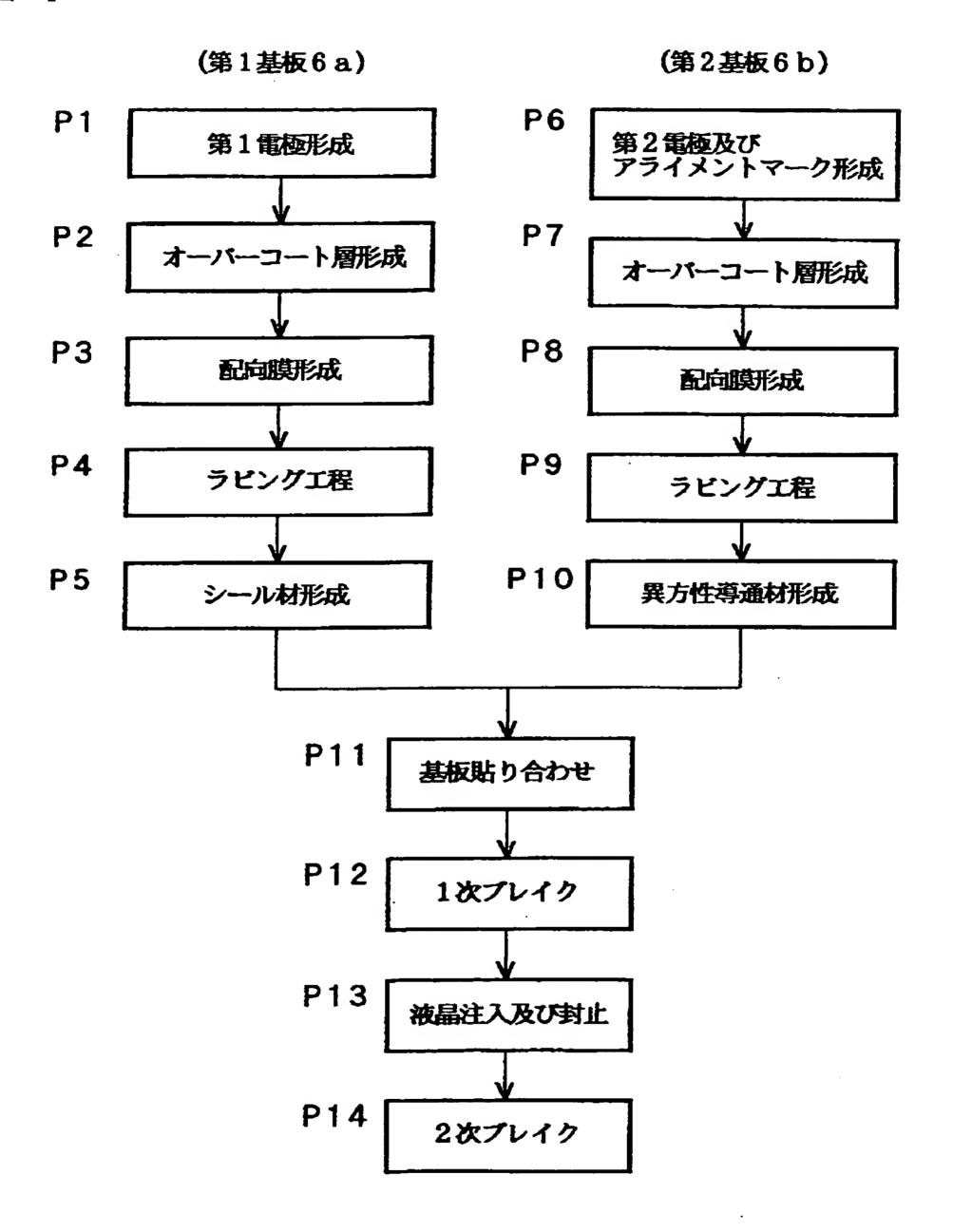
【図4】



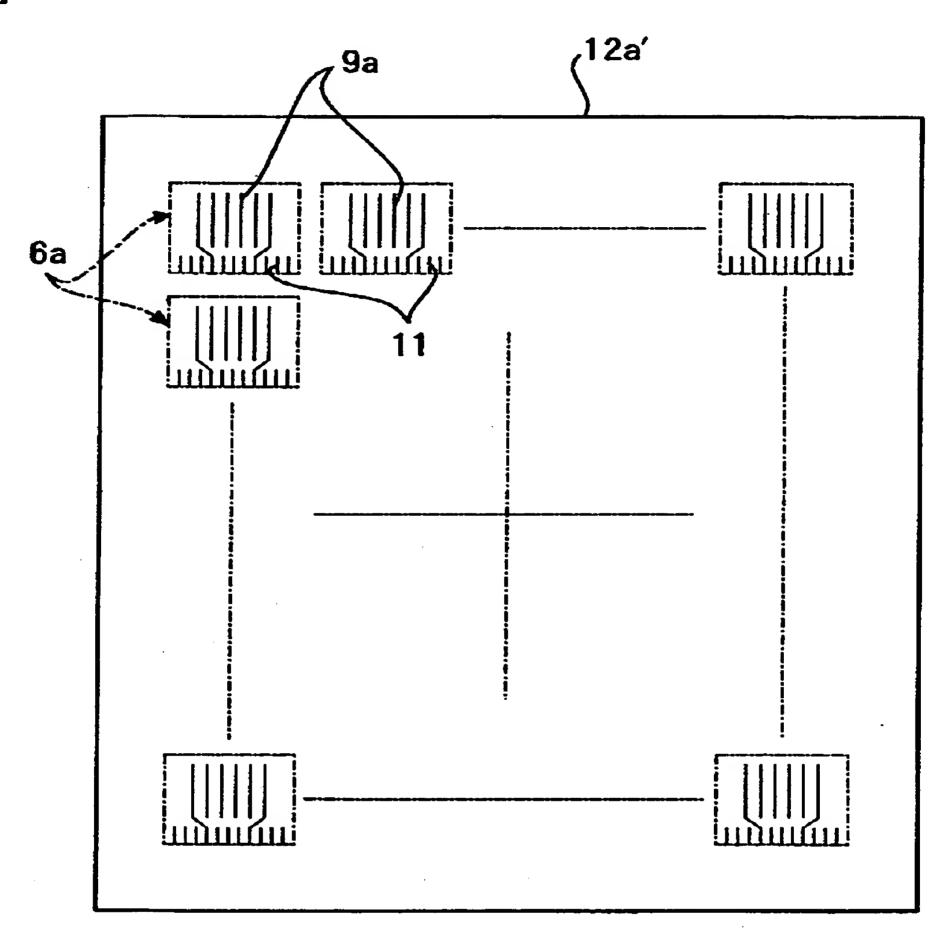


5

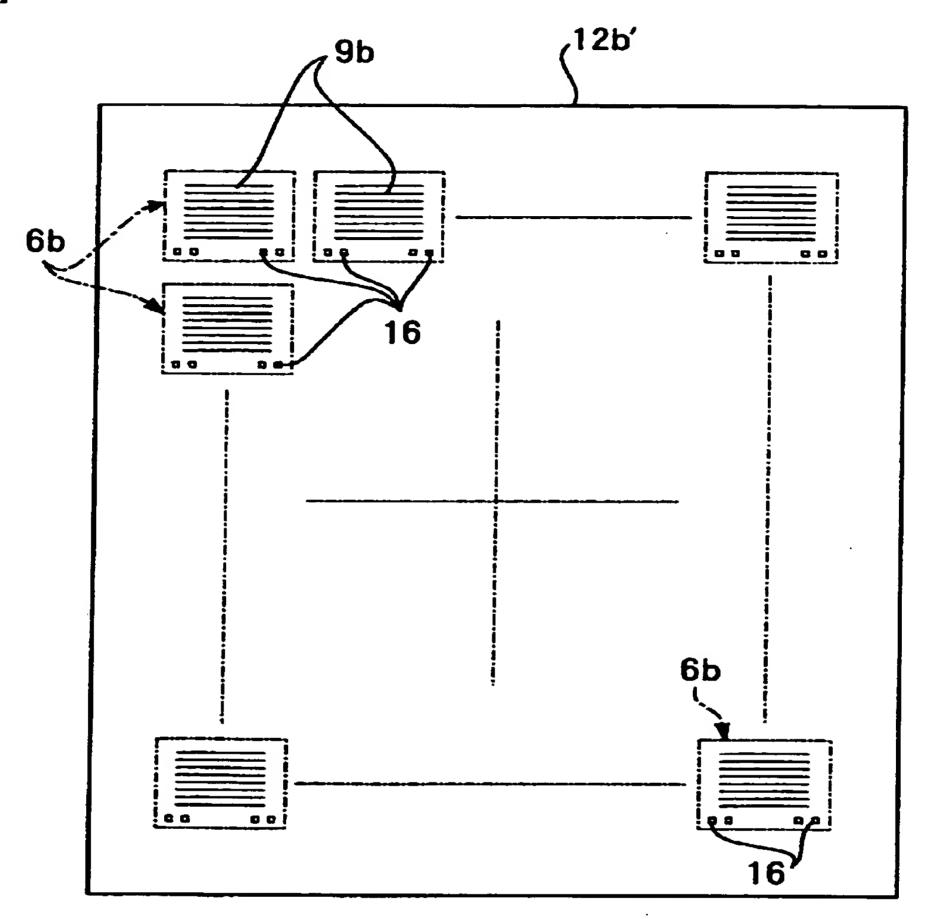
【図6】

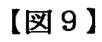


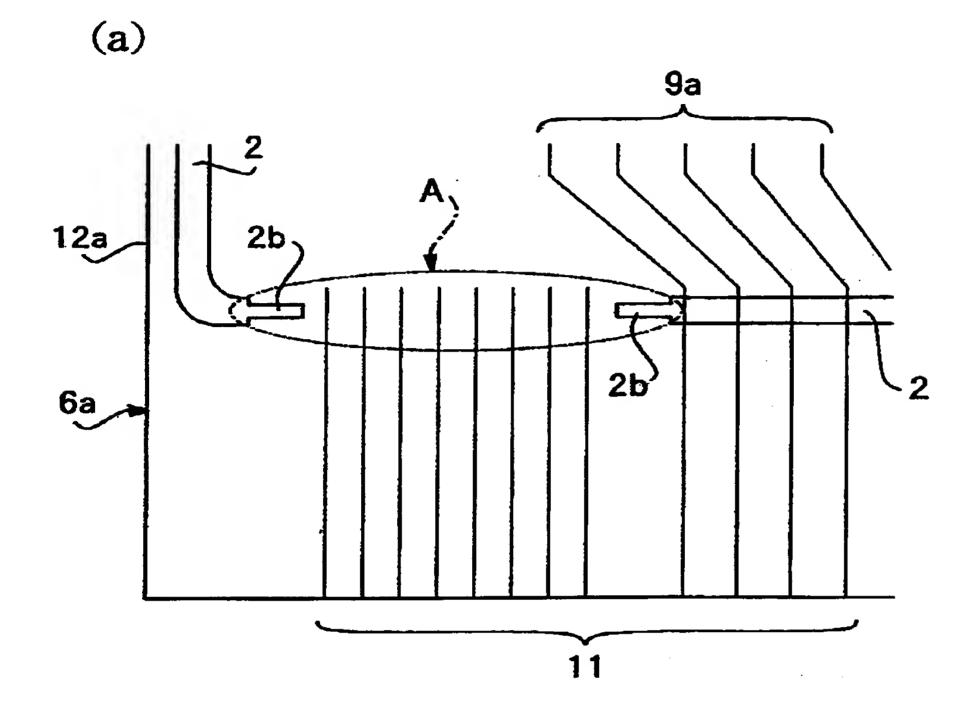
【図7】



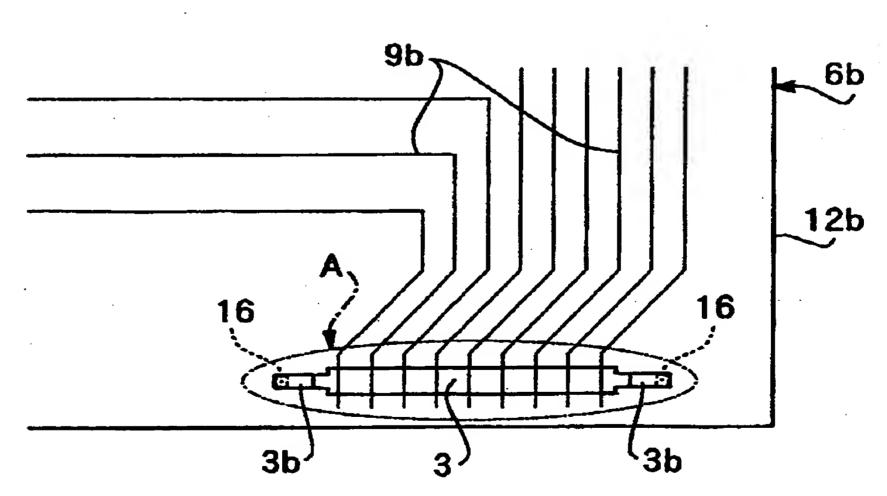
【図8】



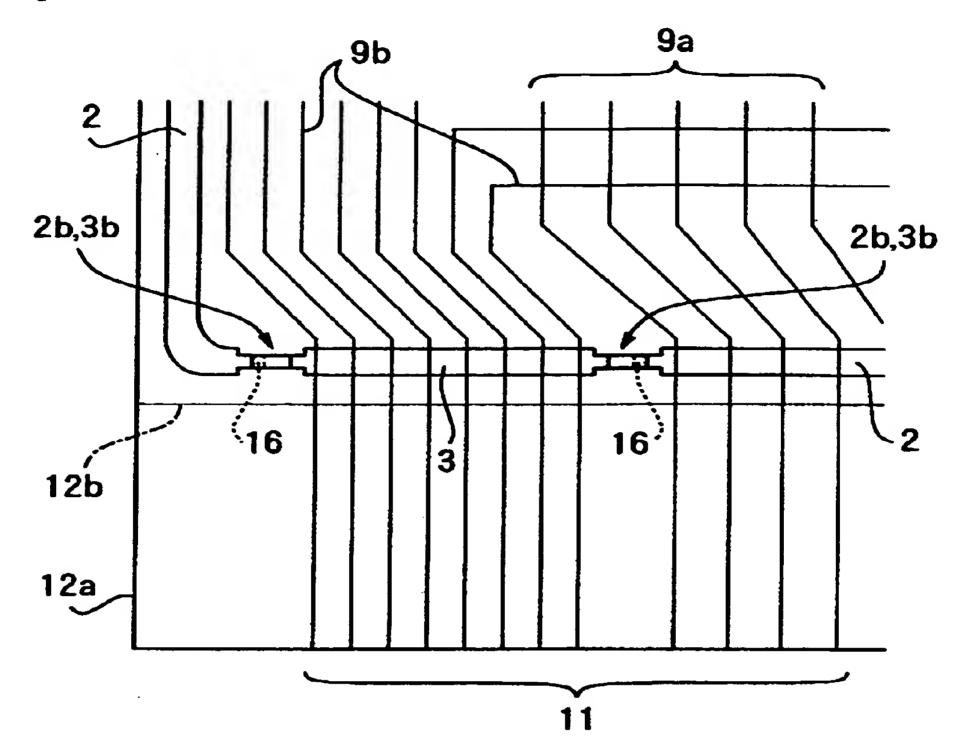




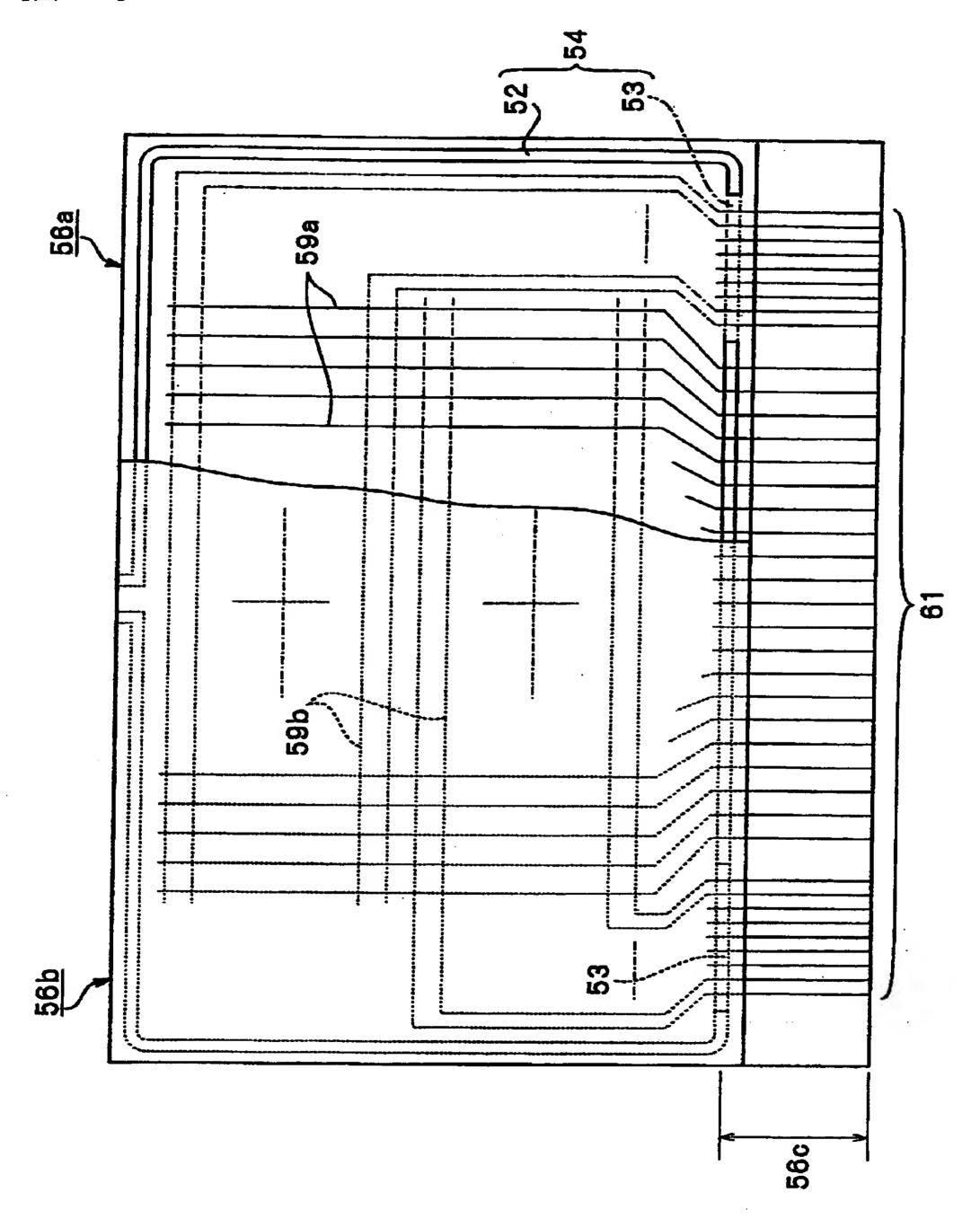




【図10】



【図11】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 シール部の一部に異方性導通材を設ける構造の液晶装置に関して、異方性導通材の位置を極めて簡単に検査できるようにする。

【解決手段】 シール材2と異方性導通材3とが互いにつながって環状に形成されたシール部4と、そのシール部4によって互いに貼り合わされた一対の基板6 a, 6 b と、それらの基板に形成された電極9 a, 9 b とを有する液晶装置である。一対の基板6 a, 6 b のうち異方性導通材3が形成される側の基板に、その異方性導通材3の位置を確認可能なアライメントマーク16を設ける。異方性導通材3の位置をでライメントマーク16と比較して確認することにより、その異方性導通材3が正常な位置に形成されているか否かを簡単且つ正確に検査できる

【選択図】 図1

出願人履歴情報

識別番号

[000002369]

1. 変更年月日 1990年 8月20日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

氏 名 セイコーエプソン株式会社